

三未信安科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐专场机构交流会 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称	线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 9 月 7 日
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张岳公 财务总监 焦友明 董事会秘书 曾添
投资者关系活动主要内容介绍	1. 了解到公司拿到了 FIPS 140-3 资质，具体有什么用？ 答:FIPS 140-3 是全球密码产品领域权威安全标准，Level 3 对物理防篡改、密钥全生命周期保护、身份鉴权、固件安全、攻击缓解能力提出严苛要求。此次认证最大亮点是模块原生完成 NIST 全套抗量子密码算法合规验证，成为国内首款密码整机类且融合抗量子能力的 FIPS 140-3 Level 3 产品。这项认证的落地，为公司进军海外金融、政务、关键基础设施市场铺平了重要的合规基础，全球业务拓展由此迈出关键一步。 2. 公司在区块链安全领域的布局情况如何？ 答:公司在区块链安全领域已有多年技术积累，相关布局进展如下：1、技术与标准层面，公司牵头制定了 GM/T

	0111-2021《区块链密码应用技术要求》，这是国内首个区块链密码行业标准，在行业规范制定层面具备先发优势。2、产品与认证层面，公司研制的首批通过国家商密认证的区块链密码机，已应用于我国多个区块链基础设施项目中。3、新的金融场景层面，公司作为香港 Web3.0 标准化协会副理事长单位，正针对 Web3.0 应用场景积极布局，重点在冷热钱包、资产托管等环节提供适配的产品或解决方案，公司的核心产品密码机（HSM）通过 FIPS140-3 Level 3 认证，全面支持 RSA、ECC 等常规密码算法以及多种抗量子算法，满足全球范围内区块链领域的安全需求。 3. 公司下游景气度如何？ 答:随着 AI 应用的进展，数据安全重要性凸显，密码产品作为数据安全的核心产品在各个领域的需求保持持续增长，公司积极与用户或下游企业合作，推广公司创新的产品与解决方案。 4. 可否介绍下 PQC 目前在相关行业试点情况及未来一年可能推广的节奏如何？ 答:公司在国内金融、能源、电信运营商、智能汽车、半导体企业等领域均有试点项目，在香港等海外市场也有试点应用，未来一年有良好的发展趋势。但受限于国内算法标准的制定进度，在国内的大规模算法迁移市场还未启动。 5. 上半年公司产品结构和以前相比是否有明显变化？ 答:上半年公司芯片、云密码服务产品增长趋势明显。 6. 管理层您好！首先恭喜公司上半年取得经营质效的提升，能否就公司下半年的业务重心和工作目标作下分享交流？国内商密市场，和海外业务分别侧重于哪些行业场景，预期能够达成哪些目标？ 答:下半年公司将加大芯片、云密码服务（云+芯形成
--	--

	独特优势)的推广。国内将继续在金融、能源、电信运营商、智能无人设备等领域开拓,海外将抓住抗量子算法替换的机遇,积极推广HSM(硬件安全模块)、密钥管理系统等产品。下半年公司将重点建设覆盖全球范围的云密码服务体系。 7. 新一代抗量子 SPU 芯片预计什么时候能够贡献规模化收入? 答:SPU 芯片已经使公司在抗量子密码产品的研发上处于行业领先地位,随着抗量子密码算法在社会上的逐步应用,该产品将产生较大的市场价值。规模化的市场贡献会发生在国内算法标准确定,各行业进行密码算法全面升级的时候。 8. 请问密码芯片收入占比? 答:上半年密码芯片占公司主营业务收入比例约为2.94%,但增长趋势明显。 9. 密码安全芯片研发升级项目当前进展如何? 答:公司形成了XS系列(服务端)、XT系列(终端)、XR系列(随机数)等三个系列的密码芯片产品,目前该项目多款产品型号已经成功量产并通过相关国密认证,已经建立了比较完善的商用密码芯片产品体系。2026年4月公司还发布了新一代抗量子SPU(Secure Processing Unit)芯片,在抗量子领域实现了关键突破。密码芯片收入也在逐步增加。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动,公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2026年9月8日